

UDC 621.3.049.75 : 678.7  
L 30



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 14709—93

---

## 挠性印制电路用涂胶聚酰亚胺薄膜

Adhesive coated polyimide film  
for flexible printed circuits

1993-11-10 发布

1994-07-01 实施

---

国家技术监督局 发布

挠性印制电路用涂胶聚酰亚胺薄膜

Adhesive coated polyimide film  
for flexible printed circuits

1 主题内容与适用范围

本标准规定了涂胶粘剂聚酰亚胺薄膜(以下简称涂胶薄膜)的产品型号、材料和组成、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于挠性印制电路覆盖层用的单面涂胶聚酰亚胺薄膜和多层挠性印制电路板用的双面涂胶聚酰亚胺薄膜。

2 引用标准

- GB 2829 周期检查计数抽样程序及抽样表(适用于生产过程稳定性的检查)
- GB/T 4721 印制电路用覆铜箔层压板通用规则
- GB/T 4722 印制电路用覆铜箔层压板试验方法
- GB/T 13557 印制电路用挠性覆铜箔材料试验方法
- GB 13555 印制电路用挠性覆铜箔聚酰亚胺薄膜

3 产品型号

涂胶聚酰亚胺薄膜有二个型号,其代号和特性如表 1。

表 1 涂胶聚酰亚胺薄膜品种和型号

型 号	特 性
PI-101	一般用途
PI-102F	限定可燃性的

4 材料和组成

本产品由单面或双面涂有胶粘剂的聚酰亚胺薄膜组成(涂胶面可以覆盖防粘膜)。

4.1 聚酰亚胺薄膜

聚酰亚胺薄膜的推荐标称厚度和极限偏差应符合表 2 规定,在供需双方同意时也可采用其他厚度。

4.2 胶粘剂

胶粘剂可以是热塑性或热固性的,但应与和它一起使用的覆铜箔聚酰亚胺薄膜相匹配。胶粘剂类型与标称厚度由供需双方商定。